

Thermal process solution provider

レジストアッシング装置

Resist Ashing System

枚葉式アッシング装置 λ 300

λ -300 - Single Wafer Resist Ashing System

特長 Features

- プラズマダメージレス
Plasma Damage-less
- Good uniformity
- 高速アッシング
High Speed Ashing
- 優れた生産性と高い稼働率
Excellent Productivity & High Operating Rate
- イージーメンテナンス
Easy Maintenance
- 省フットプリント
Small Footprint
- 200台以上の豊富な出荷実績/ホスト通信GEM
Large Shipping Record of Over 200 Units / Host Communication GEM



スペック Specifications

- ウェーハ径：300mm
Wafer Diameter: 300mm
- プラズマ方式：ラムダヘリカルリゾネータ方式
Plasma System: Lambda Helical Resonator System
- アッシングチャンバ：2チャンバ
Ashing Chamber: 2 Chambers
- ロードサイズ：シングル・ウェーハ
Load Size: Single Wafer

バッチ式アッシング装置 MG-6500R

MG-6500R - Batch Ashing System

特長 Features

- 省スペース
Small Footprint
- 高アッシングレート
High Ashing Rate
- 高スループット
High Throughput
- 低ダメージ
Low Damage

スペック Specifications

- ウェーハ径：150mm (Option 125mm, 100mm)
Wafer Diameter: 150mm
- プラズマ方式：縦型同軸電極方式
Plasma System: Vertical Coaxial Electrode System
- アッシングチャンバ：1チャンバ
Ashing Chamber: 1 Chamber
- ロードサイズ：50枚/1バッチ
Load size: 50 Sheets / 1 Batch



※200mmバッチ式アッシング装置復刻版近日リリース

※200mm Batch Type Ashing Tool Reprint Version Coming Soon

日立国際電気

国際電気セミコンダクターサービス